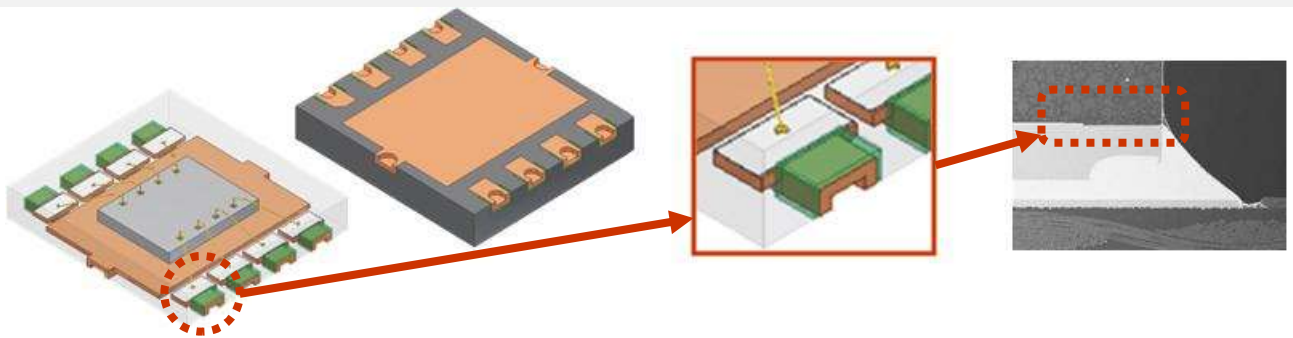


高実装信頼性パッケージ

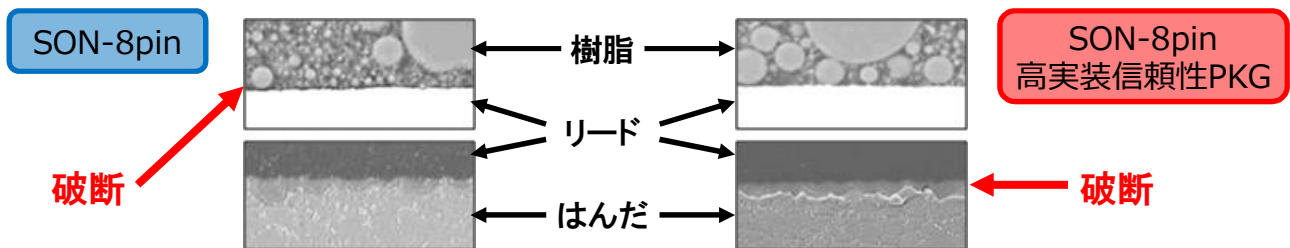
特長

- リードと封止樹脂間の応力緩和材により基板反りやねじれ等の機械的負荷への耐久性が向上する特許技術を使った実装信頼性が高いノンリードパッケージを提供いたします。



実装強度

- ・ガルウィングタイプパッケージと比較して押し強度が57%向上
 - ・リード-封止樹脂間の応力緩和材により基板曲げ耐性が66%向上
- 破断モード：リード-封止樹脂間の破断からはんだ破壊へと変移



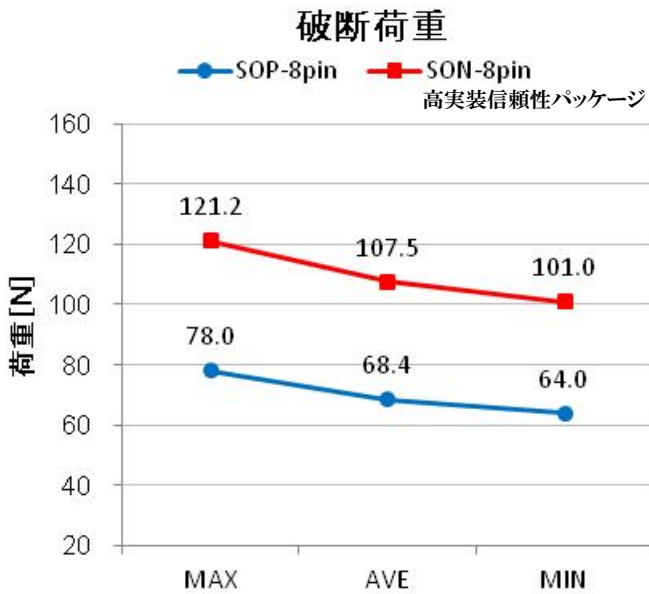
高い実装強度はガルウィングタイプパッケージからの代替を可能とし、車載向けパッケージの小型化・低背化に効果的です。

特許2015-139062（出願日：2015年7月10日）

所定仕様に従ってステージと外部接続端子とから配線パターンを形成したリードフレームと、該リードフレームのステージ上に搭載した半導体チップと、該半導体チップと上記外部接続端子を接続するワイヤと、該ワイヤ、前記半導体チップ、及び該半導体チップ搭載側のリードフレームの全域を被覆封止したモールド樹脂と、から成る半導体パッケージにおいて、上記外部接続端子とモールド樹脂間に応力緩和層を形成したことを特徴とする半導体パッケージ。

実装強度測定データ

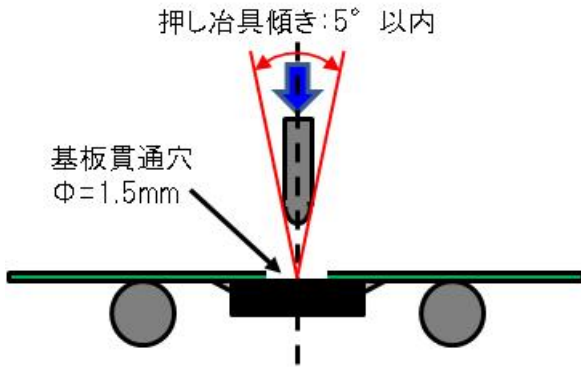
◆押し強度試験



破断までの荷重・・・57%向上
(平均値比較)

●試験条件

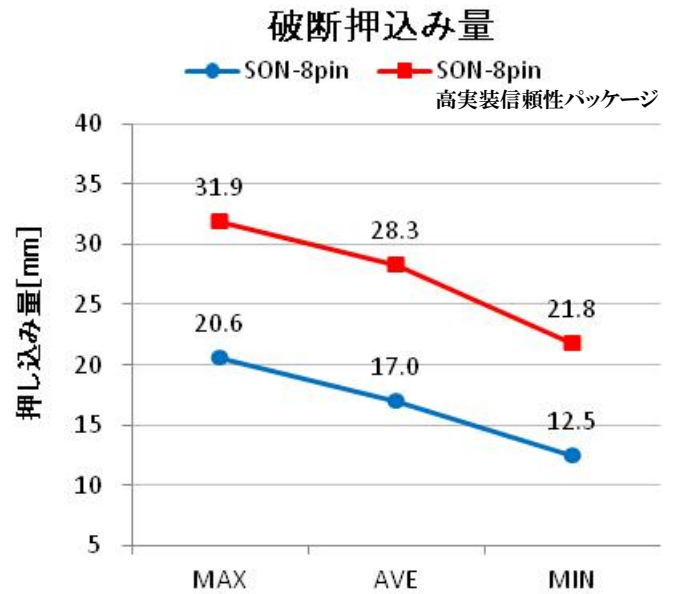
最大押し込み量：導通破断まで
押し込み速度：0.1mm/sec
参考規格：JIS:C 60068-2-21



●基板仕様

基材：ガラス布基材エポキシ樹脂銅張積層板
層数：4層
銅箔厚み：外層35 μ m/内層18 μ m
基板サイズ：130mm×30mm
基板厚み：1.6mm

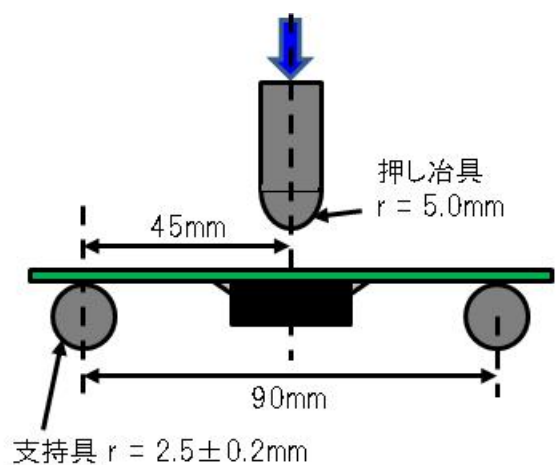
◆限界曲げ強度試験



破断までの押し込み量・・・66%向上
(平均値比較)

●試験条件

最大押し込み量：導通破断まで
押し込み速度：0.1mm/sec
参考規格：JEITA ET-7409/104A



※測定データは当社製品での比較データとなります